

2002015725

15 MAR 2002

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



162162

(43) Date de la publication internationale
7 février 2002 (07.02.2002)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 02/10779 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :

G01R 1/073

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
MESATRONIC [FR/FR]; ZAC de Champfeuillet, 130,
rue de Placyre, F-38500 Voiron (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/02411

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **BEL-
MONT, André** [FR/FR]; Hameau Le Temple, F-38490
La Batie Divisin (FR). **ROBERT, Laurent** [FR/FR]; Clos
Bérard Bate, 4, rue Brunetière, F-38500 Voiron (FR). **AIT
MANI, Abdel, Nacer** [FR/FR]; 9, rue Gay, F-38400 Saint
Martin d'Hères (FR).

(22) Date de dépôt international : 24 juillet 2001 (24.07.2001)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :

00/09930

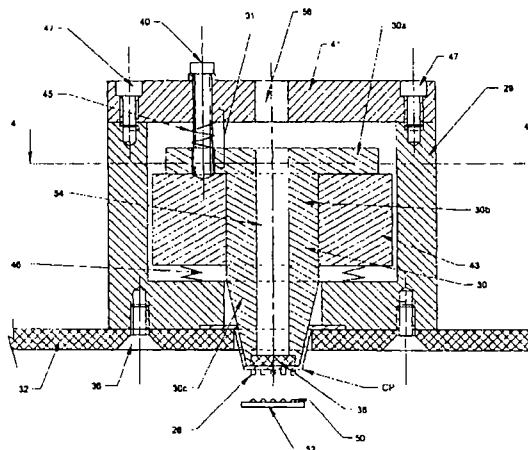
28 juillet 2000 (28.07.2000) FR

(74) Mandataire : **HECKE, Gérard**; Cabinet Hecke, WTC
Europole, 5, place Robert Schuman, B.P. 1537, F-38025
Grenoble Cedex 1 (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR MAKING A CARD WITH MULTIPLE CONTACT TIPS FOR TESTING MICROSPHERE INTE-
GRATED CIRCUITS, AND TESTING DEVICE USING SAID CARD

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CARTE A POINTES DE CONTACT MULTIPLE POUR LE TEST DE CIR-
CUITS INTEGRES A MICROBILLES, ET DISPOSITIF DE TEST UTILISANT LA CARTE



ACTION

(57) Abstract: The invention concerns a method for making a card with tips for testing semiconductor chips with microsphere bond pads. A first thin adhesive coat is vacuum deposited on a flexible polyimide film, followed by a second metal coat. A combination of UV photolithography and electroforming of a metal material enables to obtain the implantation of the tips (26). The pattern of the strip conductors is obtained by a second UV lithography operation whereby the second metal layer and the first adhesive coat are etched. An insulating protective resist is deposited on the active conductive zone. The flexible film (10) is mounted on a truncated maintaining component (30) whereof the vertical translational and planar rotational movements are made possible by a guide (43) supported on a spring suspension (46). The defective alignment between the plane of the tips (26) and the printed circuit plane (32) is corrected by a correcting system (31) with three support points adjustable with screws (40).

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une carte à pointes pour le test des puces semi-conductrices à plots de connexions du type microbilles. Une première couche mince d'accrochage est déposée sous vide sur un film souple de polyimide, suivie d'une deuxième couche métallique. Une combinaison de photolithographie UV

[Suite sur la page suivante]

WO 02/10779 A1